

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0737690100

Status:

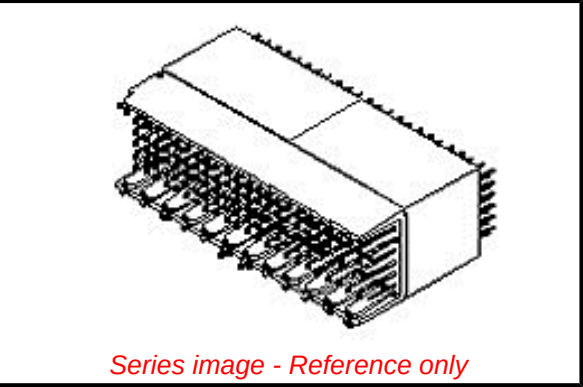
Active

Overview:

HDM® Backplane Connector System

Description:

HDM® Board-to-Board Stacking Header, High Rise Vertical, Press-Fit, Open End Option, 72 Circuits



Series image - Reference only

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-73780-999 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General	
Product Family	Backplane Connectors
Series	73769
Application	Backplane, Mezzanine
Component Type	PCB Header
Overview	HDM® Backplane Connector System
Product Name	HDM®
UPC	800753948020
Physical	
Circuits (Loaded)	72
Circuits (maximum)	72
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	200
First Mate / Last Break	No
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin-Lead
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	12.780/g
Number of Columns	12
Number of Pairs	Open Pin Field
Number of Rows	6
Orientation	Vertical
PC Tail Length	3.50mm
PCB Locator	No
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	1.40mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface	2.00mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	0.381µm
Polarized to PCB	No
Stackable	Yes
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole - Compliant Pin
Electrical	
Current - Maximum per Contact	1.0A
Data Rate	1.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)	72
Voltage - Maximum	100V AC
Solder Process Data	

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

China RoHS

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

Search Parts in this Series

73769 Series

Mates With

73632 HDM PLUS® Board-to-Board Daughtercard Receptacle. 73780 HDM® Board-to-Board Daughtercard Receptacle

Lead-free	Process Capability	N/A
Material Info		
Reference - Drawing Numbers		
Product Specification		PS-73780-999
HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation		

This document was generated on 07/01/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9